



室温固化导电银胶

A2/ HA2 产品特点

A2 / H2b为两液室温固化型导电银胶。A2为主剂，H2b为硬化剂。其使用方式与一般的A-B胶极为类似。是一种无需使任何用设备的简易电性连接方式。

此产品实现了冷组装的理想，使得电子产品的电性连结不需仅依靠高温焊锡。

此产品符合RoHS & Halogen-free规范，且不含PFOS & PFOA。

使用时，将主剂与硬化剂以50:50之重量比混合均匀后，即可用于接着不同的电子元件，静置于室温2-3小时后即可固化。应用于自动化制程时，可以采用双液混合型点胶机，将均匀混合后之胶液涂布于基材面上，然后通过隧道式热烘箱，以100 °C x 1分钟；或80 °C x 2分钟，或是60 °C x 8分钟熟化。

在以下领域有很好的适用性：导电性及电子干扰有特殊要求的中小型电子元件的粘接；镀银支架和印刷电路板的基板；大于 60*60mi的晶片的贴合；适用于柔性的基材（比如FPC等）；用于通讯产品抗电磁波（EMI）上之包封与填充；电磁波（EMI）遮罩材料。此产品系列耐溶剂，附着力强，导电率高，柔韧性好，特别适合电子线路的修补及粘接，如电极引出、跳线粘结、导线粘结、ITO粘结、电路修补、电子线路引出及射频元件的粘接，也适用于电子显微镜台上的样品粘结。

产品规格

粘度	15 ± 5 Pa.s @ 10 ³ s ⁻¹ ; Cone & plate Rheometer
主剂：硬化剂	50 : 50
比重	1.1 ± 0.1
熟化	25°C x 2-3 hours; or 60°C x 8 minutes ; 或 80°C x 2 minutes , or 100°C x 1 minutes
混合后使用期限	10-15 分钟
产品保存期限	制造后12 个月

接着物性

Test	Result	Test Spcification
Volume resistivity	< 1 mΩ·cm	Mitsubishi Chemical Loresta-EP MCP-T360; 4-probe
Peel strength @ 90°	> 0.6 kg/cm	克瑞富拉力试验机 铜箔涂膜厚 20μm 后对另一铜箔面贴合
Thermal resistance	No change in volume resistivity	80°C x 1 hours
Water resistance	No change in volume resistivity	Immersed in water @ 23°C x 1 hour
Moisture absorption	< 0.3%	IPC-TM-650 2.6.2.1